

## 导电银胶

### ● 产品描述：

**导电银胶**是由环氧树脂、固化剂、稀释剂、导电填料等材料组成，固化后形成导电通路的高分子材料具有较高的导电性。对金属、陶瓷基片、硅芯片等材料有较强的粘接性。



### ● 产品特点：

- 1) 优异的导电性及可靠性
- 2) 粘接力良好
- 3) 符合 RoHS/REACH 标准

### ● 应用领域：

- ✓ LED芯片固晶
- ✓ 半导体芯片封装
- ✓ 光电行业
- ✓ 医疗器械

### ● 使用方法：

- ❖ ESG-101：在使用前应先在室温下放置2~4小时进行回温，回温后方可施胶；
- ❖ EHG-410：可以通过手动或自动化设备点胶操作；
- ❖ 基材表面的氧化层、灰尘、水分、油污等，会对基材粘接力造成一定的影响，要想获得最好的粘接性能，建议被粘接的材料表面应当进行清洗处理。

## 导电银胶

## ● 典型性能参数:

参数	单位	ESG-101	EHG-410
颜色	---	银灰色膏状	A:银灰色膏状 B:银灰色膏状
类型	---	单组分	双组分
密度	g/cm <sup>3</sup>	3.4	3.6
硬度	Shore D	85	40
配比	---	---	1:1 (重量比)
粘度	cps	7000-9000	A:50000-80000 B:40000-60000
玻璃化转化温度	°C	125	50
体积电阻率	Ω·cm	0.0005	0.001
固化条件	---	160°C@60min	25°C@24h
应用领域	---	芯片固晶 半导体芯片封装	红外热电探测器 触摸屏各种电路修补等
保质期	Month	6	

## ● 包装方式:

ESG-101: 10mL、30 mL 或定制

EHG-410: 50mL、400 mL 或定制

## ● 存储条件:

ESG-101: -40°C低温储存

EHG-410: 室温避光保存, 湿度 < 75%